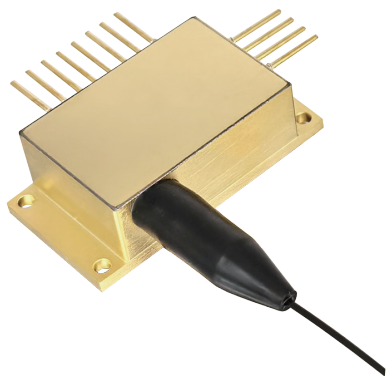




R2T封装模组

R2T封装模组是杏林睿光NL窄线宽激光器产品线的明星产品，该产品可以同时输出两种波长，适用于差分吸收拉曼，基于VBG锁波技术，配合TEC封装，实现稳定的功率输出和高的边模抑制比，具有良好的温度波长漂移特性。

主要功能特点

- ◆ 结构紧凑
- ◆ 输出稳定
- ◆ 可靠性高

应用

- 光谱分析
- 医疗应用
- 科研应用

技术参数（25℃）

封装形式		R2T			
激光器 1/激光器 2 中心波长（nm）		784.5/785.5		785/1064	
光学	连续输出功率 P _{op} （mW）	600/600		500/800	
	波长公差（nm）	±0.5			
	光谱宽度 Δλ（nm）	<0.1			
	波长随温度特性 Δλ/ΔT（nm/℃）	0.01			
电学	阈值电流 I _h （A）	0.4	0.4	0.4	0.4
	工作电流 I _{op} （A）	1.2	1.2	1.2	1.5
	工作电压 V _{op} （V）	2	2	2	1.8
	微分效率 η _{es} （W/A）	0.7	0.7	0.7	0.7
	PD电流 I _{pd} （μA）	<2000			
	热敏电阻参数 Rt（kΩ/β（25℃））	10±1%/3450			
	TEC最大电流 I _{max} （A）	8.5			
	TEC最大电压 V _{max} （V）	6.7			
光纤	光纤芯径 dcore（μm）	105			
	光纤包层直径 Dclad（μm）	125			
	光纤涂覆层直径 Dbuffer（μm）	250			
	光纤长度 L（cm）	100±10（其他长度可定制）			
	数值孔径 NA	0.22			
	连接器	FC/PC，SMA905			

以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值，最终数据以出厂测试报告为准。

其他参数

参数	工作温度（℃）	工作相对湿度（%）	存储温度（℃）	存储相对湿度（%）	引脚焊接温度（max/℃）
最小	10	-	0	-	-
最大	30	75	70	90	250(10Sec.)

